

千住金属工業

# 真空リフロー装置開発

## はんだ付け不良1%以内に抑制

千住金属工業は、真空リフロー装置「SVR-625GT」を開発した。

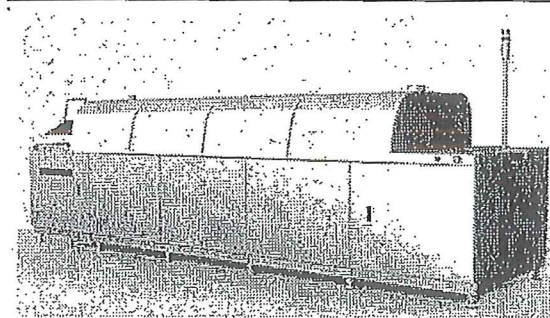
真空リフロー装置は、マウンタでプリント基板に部品を実装した後、真空中ではんだ付けを行う装置。ポイド（気泡により発生するはんだ付け不良）を抑えることができる。

SVR-625GTは、パワーデバイスや車載実装基板のはんだ接合部のポイドフリー化要求に対応する

ため、はんだメーカーの視点から開発した。はんだ付け時のはんだやフラックスの飛散を最小限に抑えるために、真空度と真空時間のコントロールを可能にした。真空ゾーンは1ゾーン、最大真空度は1<sup>キ</sup>Pa、最高温度は300度C。

同社の無残渣ペースト「NRB」シリーズと組み合わせることで、はんだ接合部のポイド発生率を1%以内

以内に抑えることができ、無洗浄も実現した。



千住金属工業の真空リフロー装置「SVR-625GT」

同社独自のインライン搬送方式で連続生産が可能。加熱方式は十字ノズルを採用した上下熱風加熱。熱量の大きなワークでも昇温ができる。加熱ゾーンは5ゾーン。最高温度300度C。

冷却ゾーンは1ゾーン。N2（窒素）雰囲気による冷却方式。

装置外形は、長さ5000×幅1340×高さ1490ミリ。既に顧客で評価を行っている。同社は年間50台の販売を目指している。